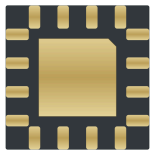
100–20000 MHz 射频开关IC — SPDT; TTL

LCI-SW-100-20000-SPDT-C · 100–20000 MHz · 射频开关IC.

RF 电气表参数: SPDT; 插入损耗 -2.2 dB (典型值); 隔离度 -45 dB (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C.

QFN16 2.5 × 2.5 mm



RF端口需外加隔直电容。

VE = -5 V; VC = 0 V: RFin ↔ RFout2

VE = -5 V; VC = 3.3 V / 5 V: RFin ↔ RFout1

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 3

RFout1: 14

RFout2: 7

VE: 9, 11

VC: 10

GND: 2, 4, 6, 8, 13, 15

NC: 1, 5, 12, 16

封装外形尺寸: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

RF 特性 TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	100	-	20000	MHz
插入损耗	IL	-	-2.2	-	dB
隔离度	ISO	-	-45	-	dB
输入驻波比	-	-	1.22	-	-
输出驻波比 (导通)	-	-	1.31	-	-
输出驻波比 (关断)	-	-	1.2	-	-

直流偏置与电流 TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
负电源电压	-	-	-	-	-5	V
负电源静态电流	-	-	0.0012	-	-	A
输入驱动电流	-	-	0.0002	-	VIH = 5 V; TTL	A

直流偏置与电流 TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
输入高电平电压	-	3	-	5	-	V
输入低电平电压	-	0	-	0.4	-	V

极限参数 极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最大输入功率	-	-	-	27	dBm
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	85	°C

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	2.5 × 2.5 × 0.75	mm

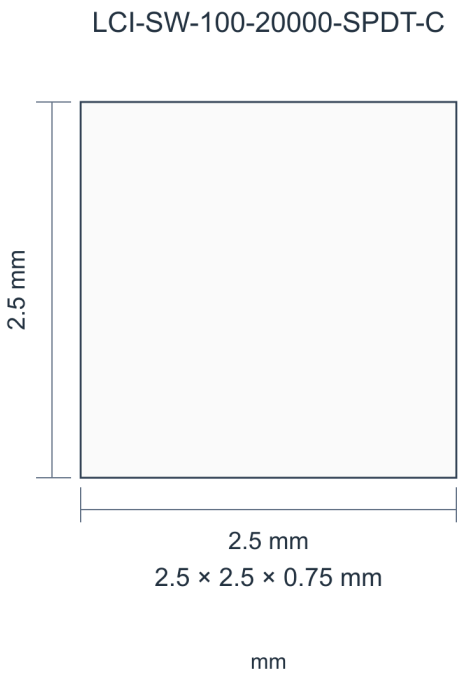
当前出版记录 · 1.3 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.2.

集成说明

QFN16 2.5 × 2.5 mm RF端口需外加隔直电容。 VE = -5 V; VC = 0 V: RFin ↔ RFout2 VE = -5 V; VC = 3.3 V / 5 V: RFin ↔ RFout1 T_peak ≤ 260 °C RFin: 3 RFout1: 14 RFout2: 7 VE: 9, 11 VC: 10 GND: 2, 4, 6, 8, 13, 15 NC: 1, 5, 12, 16

机械外形尺寸图

安装尺寸参考图，单位为 mm。图中列出部分尺寸，安装时请参照完整安装图。



文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。